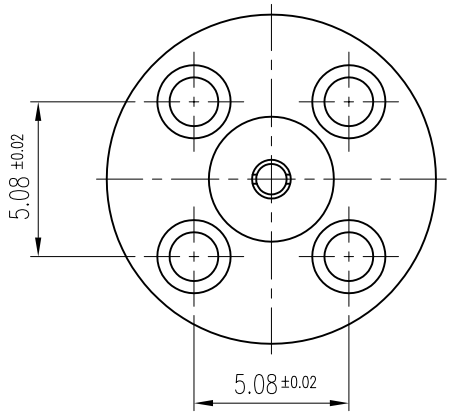
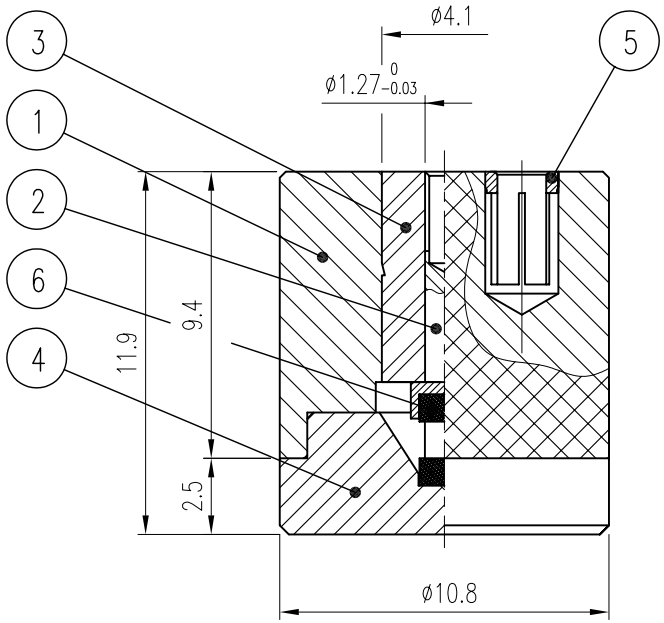
수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일





작 업 지 도 서

1. BODY ①에 Jack⑤(4EA)와 절연체③ 를 삽입 한다.
2. BODY ①에 삽입된 절연체③ 에 PIN②를 그림과 같이 삽입 한다.
3. 조립된 PIN에 저항을 삽입한다.
4. 조립된 Body와 Cover를 억지 끼움 한다.
5. 멀티미터기로 순수 저항 값을 측정 할 것.
   (저항값 : 48Ω ~ 52Ω)

품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
6	RESISTOR	1			DRE00057-N/1 (XA118)
5	JACK	4	BeCu	Gold Plate	DJA00090-5/1
4	COVER	1	MBsBD	Nickel Plate	DCV00043-5/1 (L9005)
3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00131-N/1 (H2246)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT01318-5/1
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD01694-5/1

대체가능재질

공통공차
.* ±0.1
.** ±0.05

재질

열처리

보호피막처리

년월일 2007. 12. 10.

승인

검도

제도

작성부서 연 구 소

척도 5/1 단위 mm 중량

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 MINI/UHF-LBJ용 내장용 TERM(1/8W) VER.0

A4

도번 TM00088-7/1